2024-2030年中国半导体光刻胶行业市场运行态势及发展趋向研判报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体光刻胶行业市场运行态势及发展趋向研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/1196066.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: kefu@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体光刻胶行业市场运行态势及发展趋向研判报告》共十章。首先介绍了半导体光刻胶行业市场发展环境、半导体光刻胶整体运行态势等，接着分析了半导体光刻胶行业市场运行的现状，然后介绍了半导体光刻胶市场竞争格局。随后，报告对半导体光刻胶做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体光刻胶行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体光刻胶产业有个系统的了解或者想投资半导体光刻胶行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章 半导体光刻胶行业综述及数据来源说明
1.1 光刻胶行业界定
1.1.1 光刻胶的定义
1.1.2 光刻是半导体制造微图形工艺的核心，光刻胶是关键材料
1.1.3 光刻胶技术参数
1.1.4 光刻胶所处行业
1.1.5 按下游应用分类
1、半导体光刻胶
2、显示光刻胶
3、PCB光刻胶
4、其他
1.2 半导体光刻胶行业分类
1.3 本报告研究范围界定说明
1.4 光刻胶行业市场监管&标准体系
1.5 本报告数据来源及统计标准说明
1.5.1 本报告权威数据来源
1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章 全球半导体光刻胶行业发展现状及趋势洞察
2.1 全球光刻胶行业发展历程

2.1.1 萌芽期
2.1.2 初步发展期
2.1.3 快速发展期
2.2 全球光刻胶技术进展及产品研发进度
2.2.1 全球半导体光刻胶技术进展情况
2.2.2 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度
2.3 全球半导体光刻胶行业发展现状分析
2.3.1 全球半导体光刻胶工厂分布
2.3.2 全球半导体光刻胶量产进度
2.3.3 全球半导体光刻胶细分市场
2.3.4 全球半导体产业发展现状及光刻胶需求分析
2.4 全球半导体光刻胶行业市场竞争状态及格局分析
2.4.1 全球光刻胶行业兼并重组状况
2.4.2 全球半导体光刻胶行业市场竞争格局
2.4.3 全球半导体光刻胶行业市场集中度
2.4.4 全球半导体光刻胶行业区域发展格局
2.4.5 全球半导体光刻胶重点区域市场分析
1、美国
2、日本
2.5 全球半导体光刻胶行业市场规模体量及前景预判
2.5.1 全球半导体光刻胶行业市场规模体量
2.5.2 全球半导体光刻胶行业市场前景预测
2.5.3 全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉
2.6 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴

第3章 中国半导体光刻胶行业发展现状及市场痛点
3.1 中国半导体光刻胶行业发展历程
3.2 中国半导体光刻胶行业技术进展
3.2.1 半导体光刻胶行业科研投入
3.2.2 半导体光刻胶行业科研创新
3.2.3 半导体光刻胶行业关键技术
3.2.4 半导体光刻胶制备过程
3.3 中国半导体光刻胶行业对外贸易状况
3.3.1 海关总署——半导体光刻胶归类
3.3.2 中国光刻胶进出口贸易概况

3.3.3 中国光刻胶进口贸易状况
1、光刻胶行业进口贸易规模
2、光刻胶行业进口价格水平
3、光刻胶行业进口产品结构
3.3.4 中国光刻胶出口贸易状况
1、光刻胶行业出口贸易规模
2、光刻胶行业出口价格水平
3、光刻胶行业出口产品结构
3.3.5 中国光刻胶行业进出口贸易影响因素及发展趋势
3.4 中国半导体光刻胶行业市场主体
3.4.1 半导体光刻胶行业市场主体类型
3.4.2 半导体光刻胶行业企业入场方式
3.5 中国半导体光刻胶行业市场供给分析
3.5.1 半导体光刻胶企业仍然较少
3.5.2 光刻胶产量（万吨）
3.5.3 半导体光刻胶主要企业产能
3.6 中国半导体光刻胶行业市场需求分析
3.6.1 半导体光刻胶需求量（万吨）
3.6.2 半导体光刻胶行业自给率
3.6.3 半导体光刻胶市场行情走势
3.7 中国半导体光刻胶行业市场规模体量
3.7.1 中国光刻胶行业市场规模体量
3.7.2 半导体光刻胶行业市场规模体量
3.8 中国半导体光刻胶行业市场竞争格局
3.8.1 中国半导体光刻胶行业企业竞争格局
3.8.2 中国半导体光刻胶行业市场集中度
3.9 中国半导体光刻胶国产替代布局现状
3.9.1 中国半导体光刻胶国产替代必然性分析
1、半导体光刻胶处于各行业产业链上游，具有举足轻重的地位
2、半导体材料国产化的必然趋势
3、光刻胶国产代替是中国半导体产业的迫切需要
3.9.2 中国半导体光刻胶国产替代现状
3.9.3 中国半导体光刻胶国产替代趋势
3.10 中国半导体光刻胶行业市场发展痛点

第4章 半导体光刻胶产业链全景及配套产业发展
4.1 半导体光刻胶产业链结构梳理
4.2 半导体光刻胶产业链生态图谱
4.3 半导体光刻胶产业链区域热力图
4.4 半导体光刻胶行业成本投入结构
4.4.1 光刻胶在半导体成本中的比重
4.4.2 光刻胶原材料构成及主要作用
4.4.3 半导体制造材料成本结构
4.4.4 日本和美国主导全球光刻胶原材料市场
4.5 光刻胶原材料：光刻胶单体及树脂
4.5.1 光刻胶用树脂类型及特征
4.5.2 光刻胶单体概述
4.5.3 树脂市场供应情况
1、产品供应情况
2、产品供应商情况
3、产品价格情况
4.5.4 光刻胶用树脂发展趋势
4.6 光刻胶原材料：光敏材料
4.6.1 光刻胶用光敏材料概述
1、光引发剂
2、光致产酸剂——光酸（PAG）
4.6.2 光引发剂市场供应情况
1、产品供应情况
2、产品供应商情况
3、产品价格情况
4.6.3 光刻胶用光引发剂发展趋势
4.7 光刻胶原材料：溶剂
4.7.1 光刻胶用溶剂概述
4.7.2 溶剂市场供应情况
1、产能建设及产品应用情况
2、产品供应情况
3、产品供应商情况
4、产品价格情况
4.7.3 光刻胶用溶剂发展趋势
4.8 光刻胶原材料：其他助剂

4.9 配套产业布局对半导体光刻胶行业的影响总结

第5章 中国半导体光刻胶行业细分产品市场分析
5.1 中国半导体光刻胶行业细分市场概况
5.1.1 中国半导体光刻胶行业细分市场对比
5.1.2 中国半导体光刻胶行业细分市场结构
5.2 半导体光刻胶细分市场：G线光刻胶
5.2.1 G线光刻胶概述
5.2.2 G线光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.3 半导体光刻胶细分市场：I线光刻胶
5.3.1 I线光刻胶概述
5.3.2 I线光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.4 半导体光刻胶细分市场：KrF光刻胶
5.4.1 KrF光刻胶概述
5.4.2 KrF光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.5 半导体光刻胶细分市场：ArF光刻胶
5.5.1 ArF光刻胶概述
5.5.2 ArF光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.6 半导体光刻胶细分市场：EUV光刻胶
5.6.1 EUV光刻胶概述
5.6.2 EUV光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模

3、国产化进程
5.7 中国半导体光刻胶行业细分市场影响因素及发展趋势
5.7.1 半导体光刻胶细分市场影响因素
5.7.2 半导体光刻胶细分市场发展趋势
5.8 中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析

第6章 中国半导体光刻胶行业细分应用市场分析
6.1 半导体产业市场现状
6.1.1 全球半导体产业向中国大陆转移
6.1.2 中国半导体产业市场规模
6.1.3 中国半导体产业细分市场
6.1.4 中国集成电路市场规模
6.1.5 中国集成电路市场结构
6.2 中国半导体产业趋势前景
6.2.1 中国半导体产业前景预测
6.2.2 中国半导体产业发展趋势
6.3 半导体光刻胶细分应用领域分布
6.4 半导体光刻胶细分应用：逻辑IC
6.4.1 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述
6.4.2 逻辑IC市场现状及发展趋势
1、逻辑IC市场现状
2、逻辑IC发展趋势
6.4.3 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状
6.4.4 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.5 半导体光刻胶细分应用：动态随机存取存储器（DRAM）
6.5.1 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概述
6.5.2 动态随机存取存储器（DRAM）市场现状及发展趋势
1、动态随机存取存储器（DRAM）市场现状
2、动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势
6.5.3 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场现状
6.5.4 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.6 半导体光刻胶细分应用：NVM（非易失性内存）
6.6.1 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用概述
6.6.2 NVM（非易失性内存）市场现状及发展趋势
1、NVM（非易失性内存）市场现状

2、NVM（非易失性内存）发展趋势
6.6.3 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场现状
6.6.4 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.7 中国半导体光刻胶行业细分应用市场战略地位分析

第7章 全球及中国半导体光刻胶企业布局案例解析
7.1 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理
7.2 全球半导体光刻胶主要企业布局案例分析
7.2.1 日本合成橡胶（JSR）
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.2 日本信越化学
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.3 日本东京应化（TOK）
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.4 美国杜邦
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.5 日本富士胶片
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.3 中国半导体光刻胶主要企业布局案例分析
7.3.1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.2 晶瑞电子材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.3 深圳市容大感光科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.4 江苏南大光电材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.5 上海新阳半导体材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.6 彤程新材料集团股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.7 厦门恒坤新材料科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.8 上海飞凯材料科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.9 北京欣奕华科技有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势

7.3.10 北京科华微电子材料有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势

第8章 中国半导体光刻胶行业发展环境洞察&SWOT分析
8.1 中国半导体光刻胶行业经济（Economy）环境分析
8.1.1 中国宏观经济发展现状
8.1.2 中国宏观经济发展展望
8.1.3 中国半导体光刻胶行业发展与宏观经济相关性分析
8.2 中国半导体光刻胶行业社会（Society）环境分析
8.2.1 中国半导体光刻胶行业社会环境分析
8.2.2 社会环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结
8.3 中国半导体光刻胶行业政策（Policy）环境分析
8.3.1 国家层面半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读
1、国家层面半导体光刻胶行业政策汇总及解读
2、国家层面半导体光刻胶行业规划汇总及解读
8.3.2 31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读
1、31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总
2、31省市半导体光刻胶行业发展目标解读
8.3.3 国家重点规划/政策对半导体光刻胶行业发展的影响
8.3.4 政策环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结
8.4 中国半导体光刻胶行业SWOT分析

第9章 中国半导体光刻胶行业市场前景及发展趋势分析
9.1 中国半导体光刻胶行业发展潜力评估
9.2 中国半导体光刻胶行业未来关键增长点分析
9.3 中国半导体光刻胶行业发展前景预测
9.4 中国半导体光刻胶行业发展趋势预判
9.4.1 中国半导体光刻胶行业市场竞争趋势
9.4.2 中国半导体光刻胶行业技术创新趋势
9.4.3 中国半导体光刻胶行业细分市场趋势
1、EUV光刻胶的比重将会提升
2、ArF光刻胶国产替代有望加快

第10章 中国半导体光刻胶行业投资战略规划策略及建议
10.1 中国半导体光刻胶行业进入与退出壁垒
10.1.1 半导体光刻胶行业进入壁垒分析
1、技术壁垒
2、客户认证壁垒
3、设备壁垒
4、原材料壁垒
5、资金壁垒
6、资质壁垒
10.1.2 半导体光刻胶行业退出壁垒分析
10.2 中国半导体光刻胶行业投资风险预警
10.3 中国半导体光刻胶行业投资机会分析
10.3.1 半导体光刻胶产业链薄弱环节投资机会
10.3.2 半导体光刻胶行业细分领域投资机会
10.3.3 半导体光刻胶行业区域市场投资机会
10.3.4 半导体光刻胶产业空白点投资机会
10.4 中国半导体光刻胶行业投资价值评估
10.5 中国半导体光刻胶行业投资策略与建议

图表目录

图表1：光刻胶的定义
图表2：一种NMOS三极管集成电路结构的制造过程
图表3：半导体光刻胶涂抹方法
图表4：光刻胶主要技术参数
图表5：本报告研究领域所处行业
图表6：光刻胶行业所属的国民经济分类
图表7：光刻胶专业术语
图表8：光刻胶概念辨析
图表9：光刻胶按下游应用分类
图表10：半导体光刻胶产品分类及特征
图表11：半导体光刻胶行业分类
图表12：本报告研究范围界定
图表13：光刻胶行业监管体系及机构介绍
图表14：GB/T 16527-2023年（硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂）基本内容
图表15：晶瑞电材光刻胶企业标准汇总

图表16：Q/320506 ZRH47-2020（I线正性光刻胶）部分产品标准内容
图表17：本报告权威数据资料来源汇总
图表18：本报告的主要研究方法及统计标准说明
图表19：全球光刻胶行业在萌芽期的重要事件
图表20：全球光刻胶行业在初步发展期的重要事件
图表21：全球光刻胶行业在快速发展期的重要事件
图表22：全球半导体光刻胶技术进展情况
图表23：全球半导体光刻胶厂商产品研发进度情况
图表24：全球半导体光刻胶工厂分布情况
图表25：全球半导体光刻胶行业主要企业生产进度
图表26：全球半导体光刻胶行业细分产品应用占比（单位：%）
图表27：全球光刻胶应用结构（单位：%）
图表28：全球光刻胶行业主要兼并、重组事件
图表29：全球光刻胶行业的竞争梯队（按市场份额）
图表30：全球光刻胶行业市场份额（单位：%）
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/1196066.html